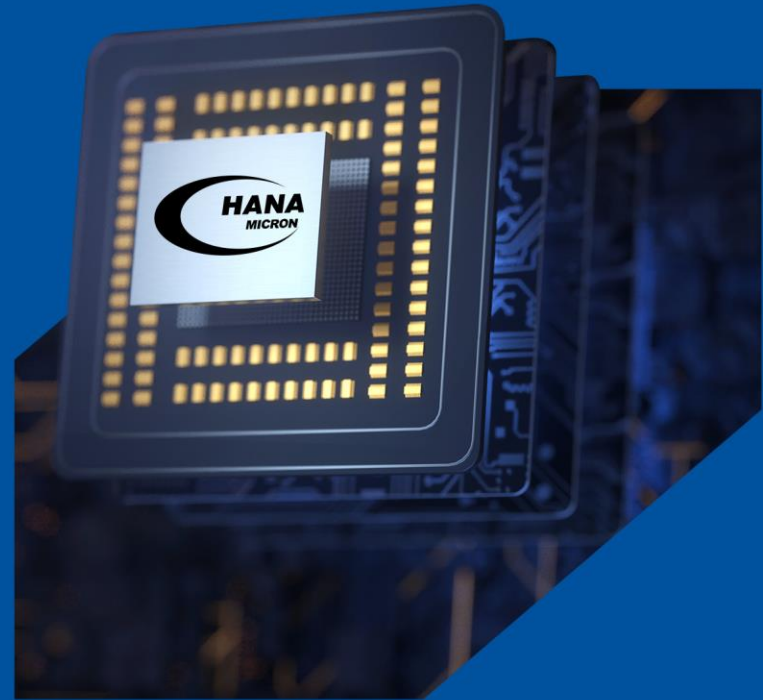


INVESTOR RELATIONS 2025

INNOVATIVE SEMICONDUCTOR SOLUTION PROVIDER

고객의 Needs에 맞는 최적의 솔루션을 찾아 제안합니다.



DISCLAIMER

본 자료는 하나마이크론(주)(이하 “회사”)의 분할 관련하여 주주 및 투자자에 대한 정보 제공의 목적으로 작성되었으며 본 자료를 복사, 재생, 배포 또는 게재하거나 다른 목적으로 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 presentation에 참석하는 경우 위 내용에 대한 동의로 간주되며 만일 위 사항을 위반하는 경우 동시에 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’의 위반에도 해당 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별적인 확인 절차를 거치지 않은 정보입니다. 이는 과거가 아니라 향후 예상되는 미래의 회사 경영현황 및 재무실적을 의미하는 것으로서, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어가 사용된 경우는 “예측정보”를 가리킵니다.

“예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 영향을 받을 수 밖에 없어 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제의 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려하여 작성된 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 투자자에 대한 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 과실 등의 여부를 불문하고 여하한 책임도 부담하지 아니합니다.

본 자료는 주식의 모집 또는 매매의 청약에 대한 권유에 해당되지 아니합니다.

The background of the slide is a collage of four images: a close-up of a precision manufacturing tool on the left, a view of the Earth from space in the center, a glowing blue circuit board on the right, and a close-up of a silicon wafer on the bottom right. The overall color scheme is dark blue with white and light blue highlights.

Better Solution for a Better Tomorrow

끊임없는 기술혁신으로
반도체의 새로운 가치를 만들어 갑니다.

TABLE OF **CONTENTS**

Chapter 01. **지주회사 개편 로드맵**

Chapter 02. **중장기 성장 전략**

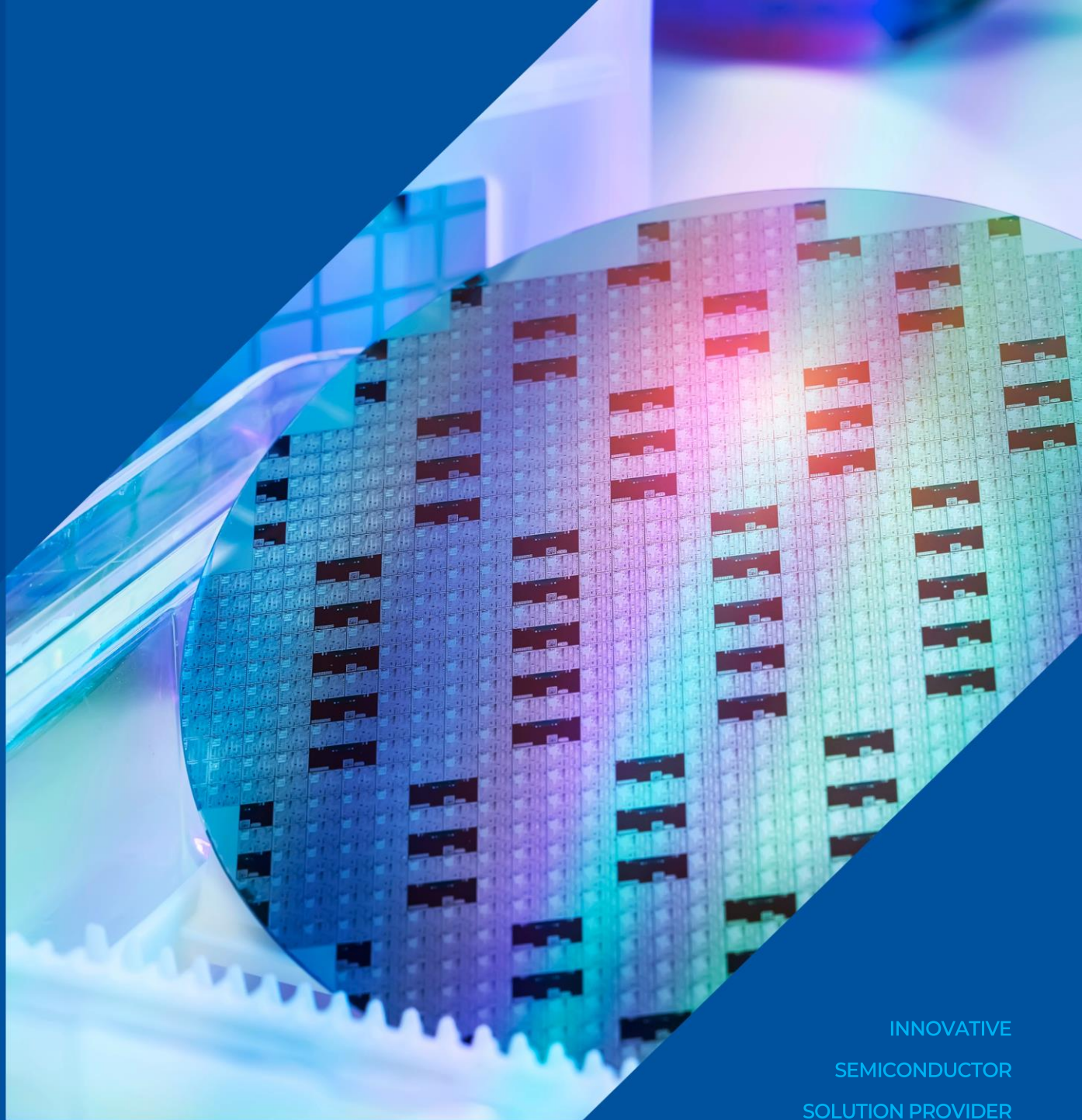
APPENDIX



01

지주회사 개편 로드맵

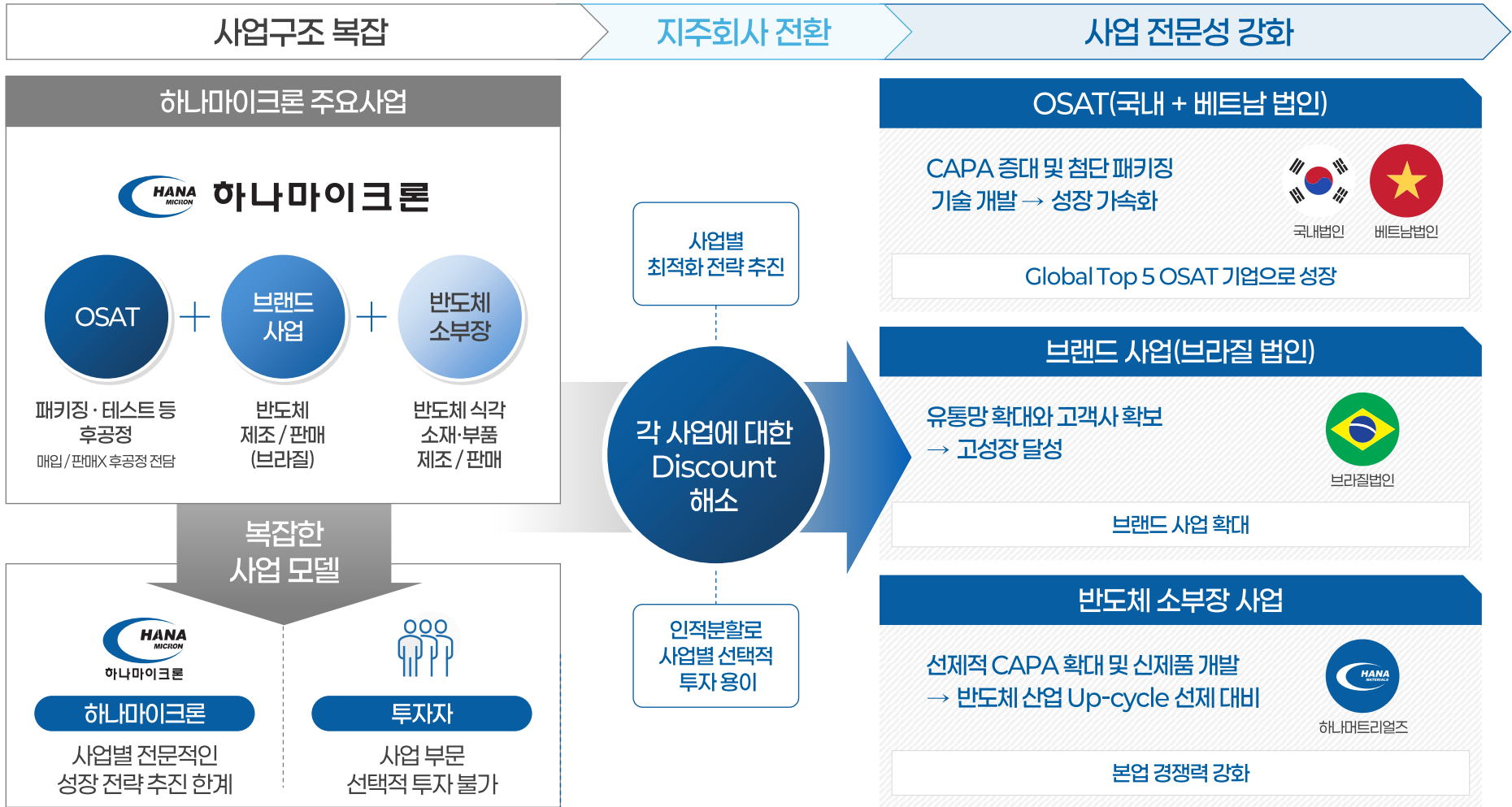
1. 지주회사 추진 배경 (1), (2)
2. 지배구조 개편
3. 지주회사 개편 후 지배구조
4. 인적분할 개요



INNOVATIVE
SEMICONDUCTOR
SOLUTION PROVIDER

01. 지주회사 추진 배경 (1)

사업구조 복잡 → 지주회사 전환으로 비즈니스 전문성 강화



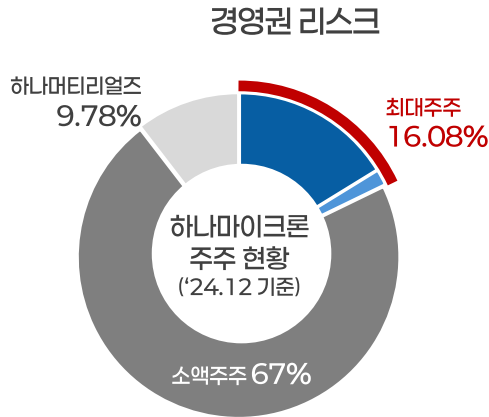
01. 지주회사 추진 배경 (2)

지주회사 체제 개편으로 경영권 및 지배구조 안정화

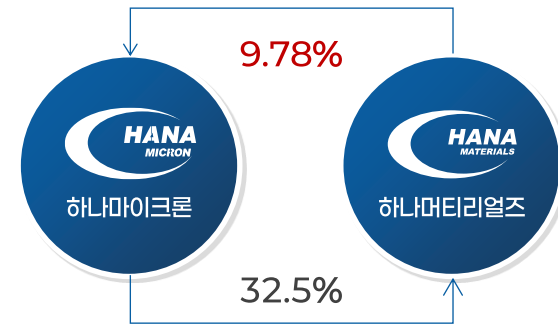
낮은 경영권 지분율

상호출자 리스크

현재



상호출자 리스크

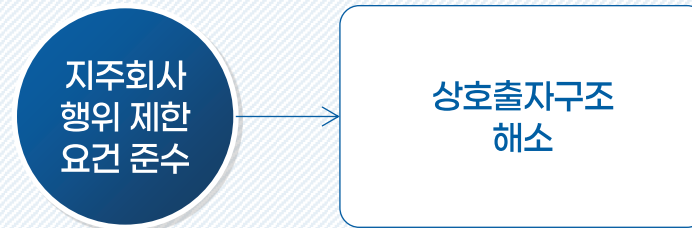


지주사 전환
기대효과

경영권 리스크 해소



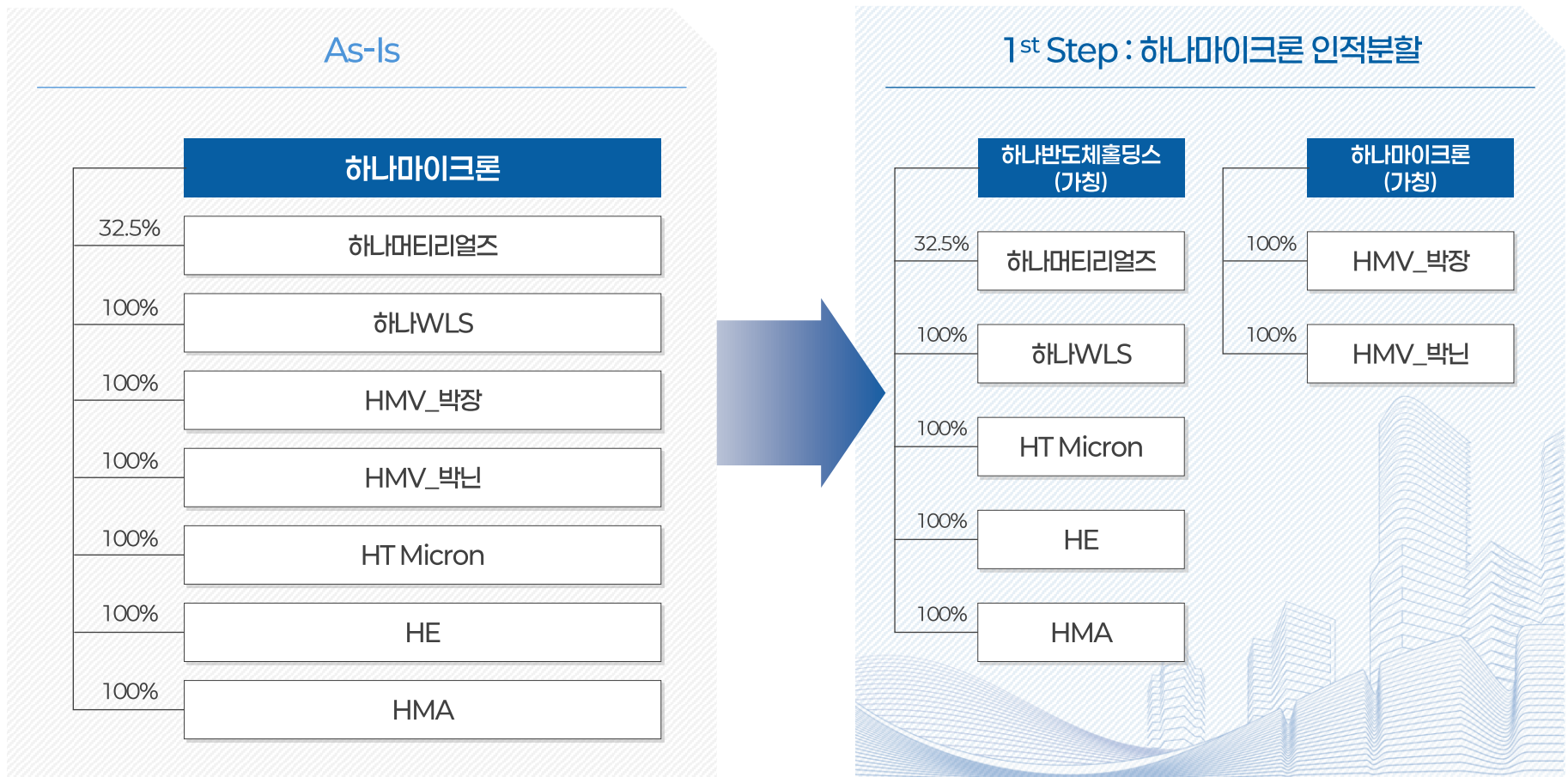
상호 출자 구조 해소로 경영투명성 및 기업독립성 강화



02. 지배구조 개편

반도체 지주회사 체제 개편을 위한 첫 번째 단계, 하나마이크론 인적분할

인적분할 개편 전/후 지배구조



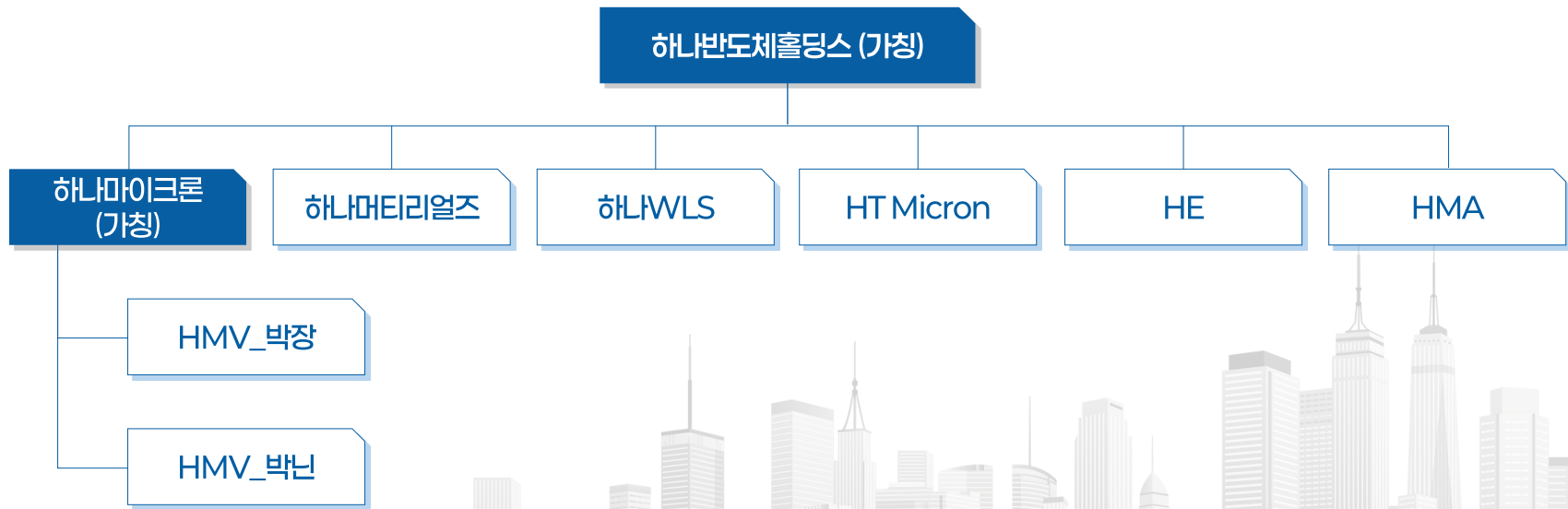
주1 : 인적분할 이후 지주회사 전환 시 하나반도체홀딩스-하나머티리얼즈간 상호 출자로 지주사 행위제한 요소 존재, 이를 위한 방안으로 분할 합병, 주식 양수도 등을 포함한 다양한 방안 고려 중

주2 : 계열회사 보유 지분율은 2024년 3분기 기준이며 하나WLS는 2024년 4분기 중 지분율 변동을 반영함

03. 지주회사 개편 후 지배구조

지주회사 체제로 책임 경영 강화 · 사업 전문성 집중

지주회사 개편 후 지배구조



사업 전문성 강화 + 사업부문 역량 집중



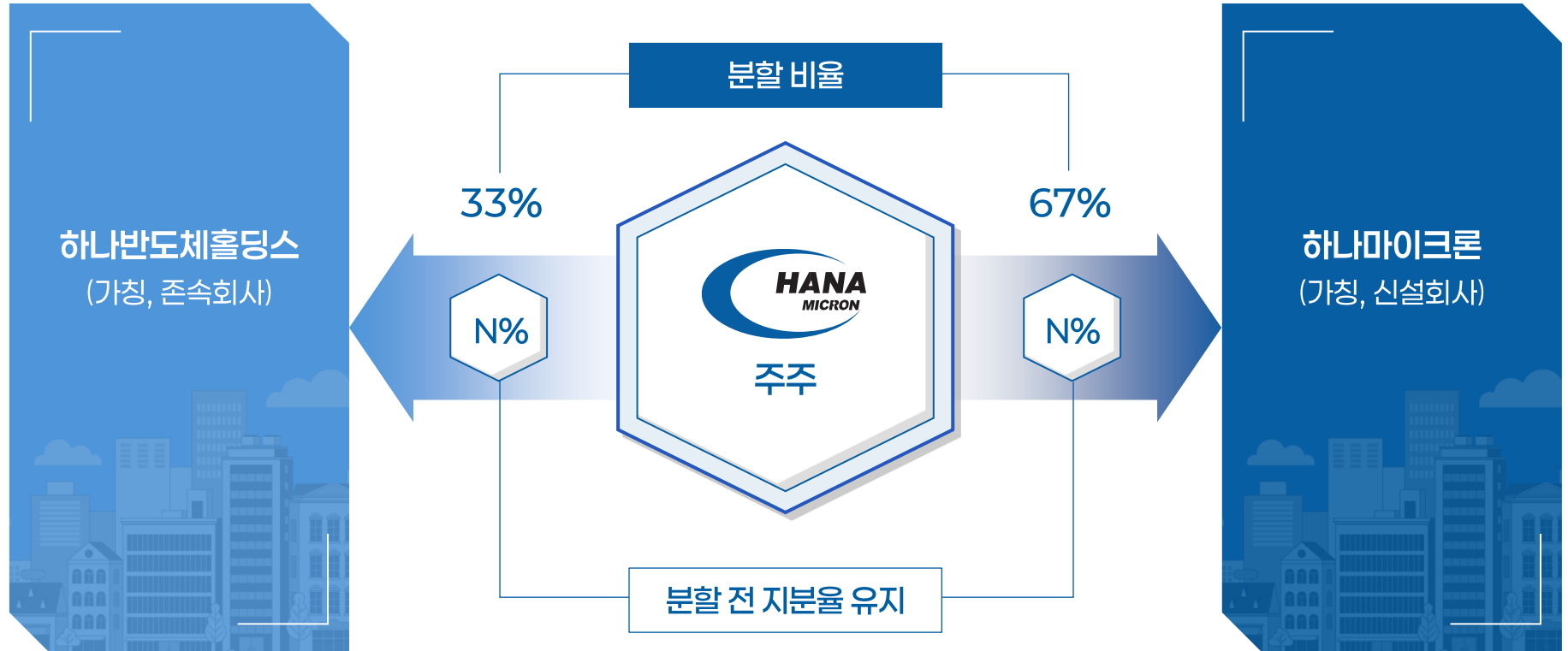
자회사 관리 + 신규사업투자

책임 경영 강화 및 경영 자원의 효율적 배분 → 기업가치 극대화

주: 인적분할 이후 지주회사 전환 시 하나반도체홀딩스-하나머티리얼즈간 상호 출자로 지주사행위 제한 요소 존재, 이를 위한 방안으로 분할 합병, 주식 양수도 등을 포함한 다양한 방안 고려 중

04. 인적분할 개요

순자산 기준으로 인적분할 비율 산정 → 기존 주주에게 산정 비율에 따라 신설회사 주식 배정



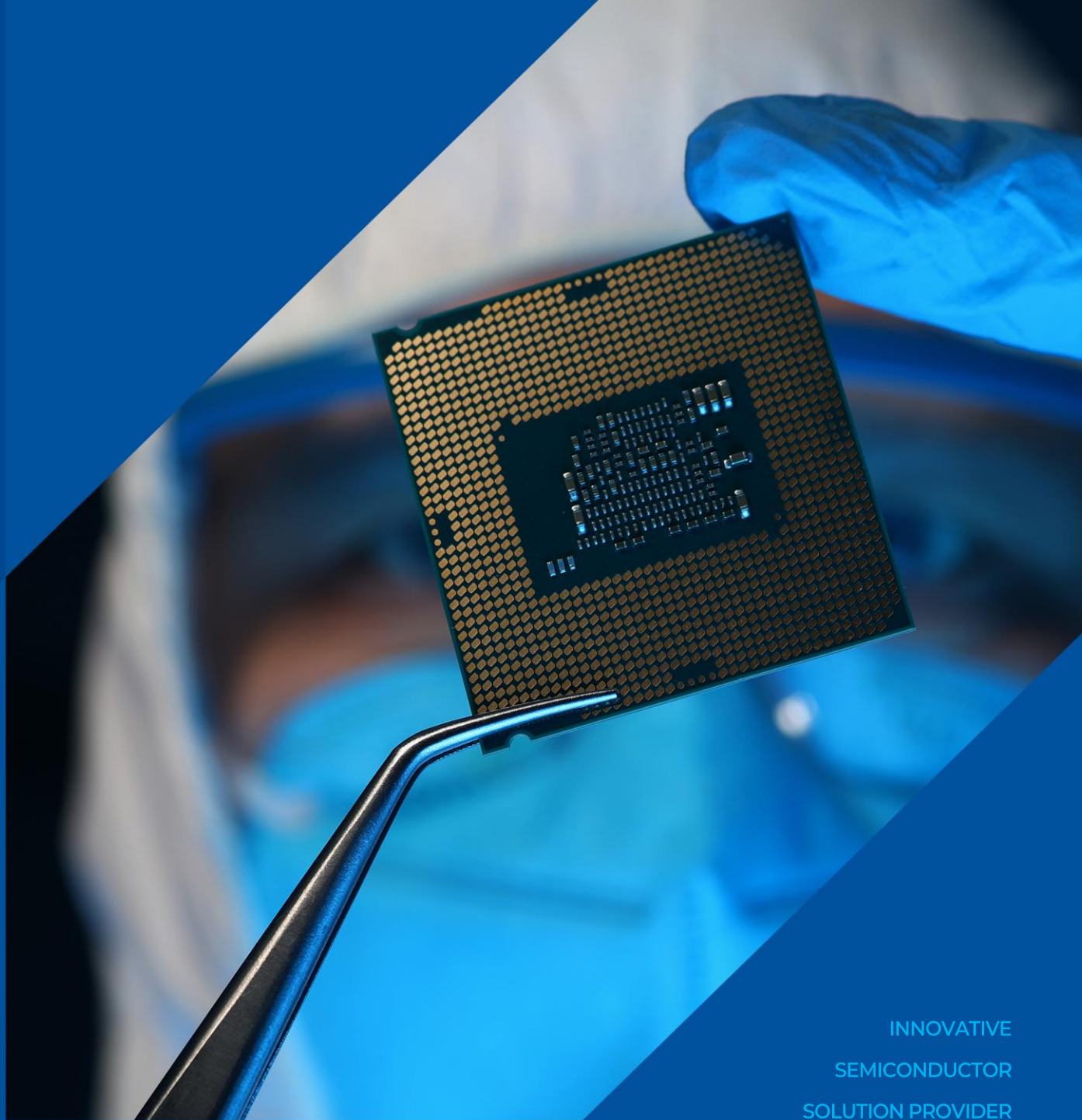
존속 / 신설회사 주식을 분할 비율에 따라 동시 보유 → 각각의 사업 성과가 주주 가치에 반영



02

중장기 성장 전략

1. 중장기 성장 로드맵
2. 하나마이크론 (1), (2)
3. 브라질 법인
4. 하나머티리얼즈



INNOVATIVE
SEMICONDUCTOR
SOLUTION PROVIDER

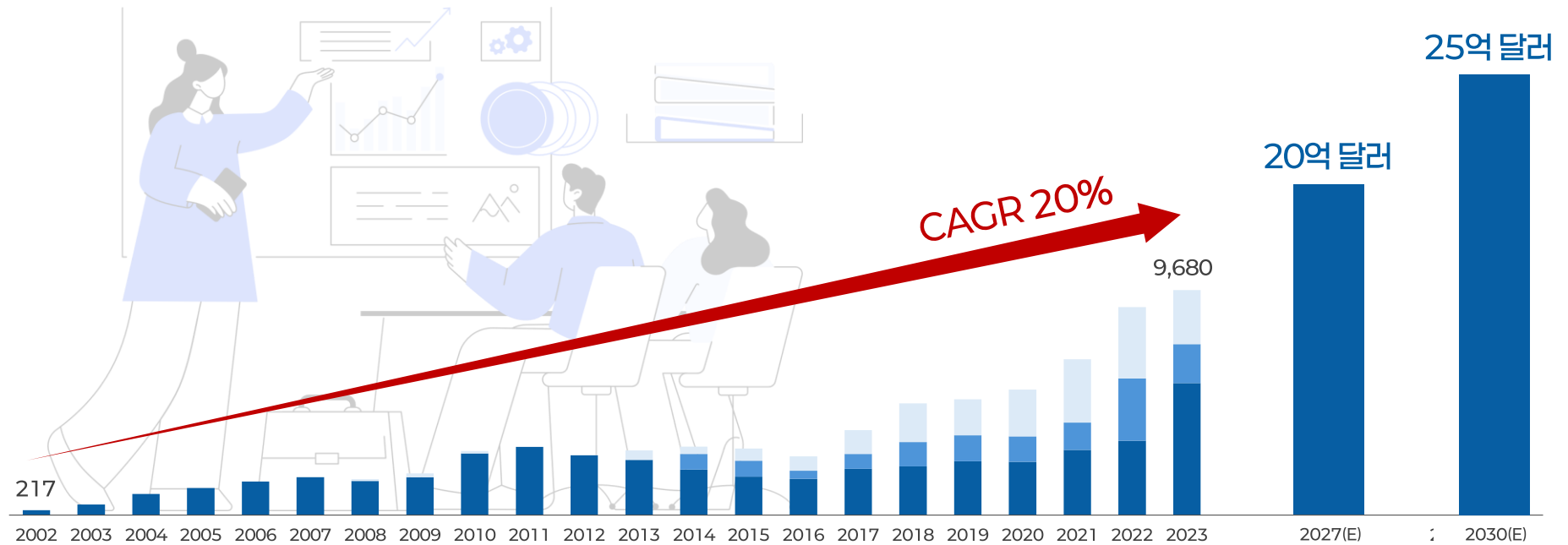
01. 중장기 성장 로드맵

설립 이후 견조한 성장세 실현 → 2030년 Global Top 5 OSAT 기업으로 도약



하나마이크론 매출액(연결, 억 원)

■ 하나마이크론(아산+베트남) ■ 브라질 법인 ■ 하나머티리얼즈



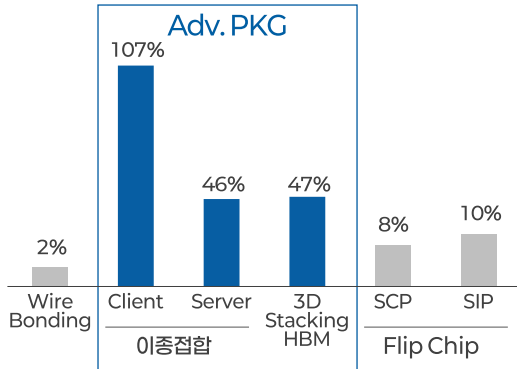
02. 하나미크론 (1) 아산

패키징 역량 고도화 → 2030년 매출액 16.2억 달러 달성 목표

반도체 패키지 패러다임 변화

과거: Chip 중심 (칩 보호 및 신호연결 등 기본적인 역할)
↓
현재: 시스템 통합 (이종 칩결합을 통한 성능 향상)

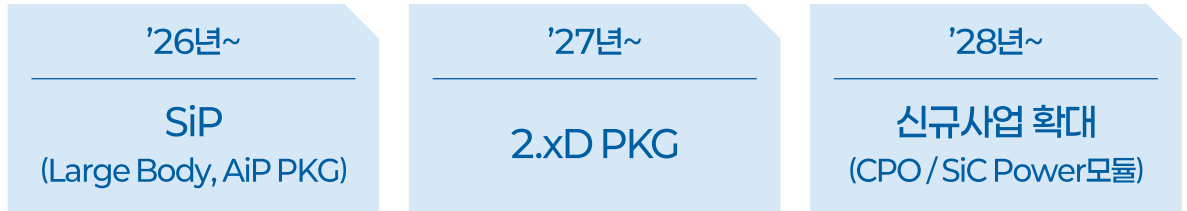
패키지 타입별 연평균 성장률('23~'28)



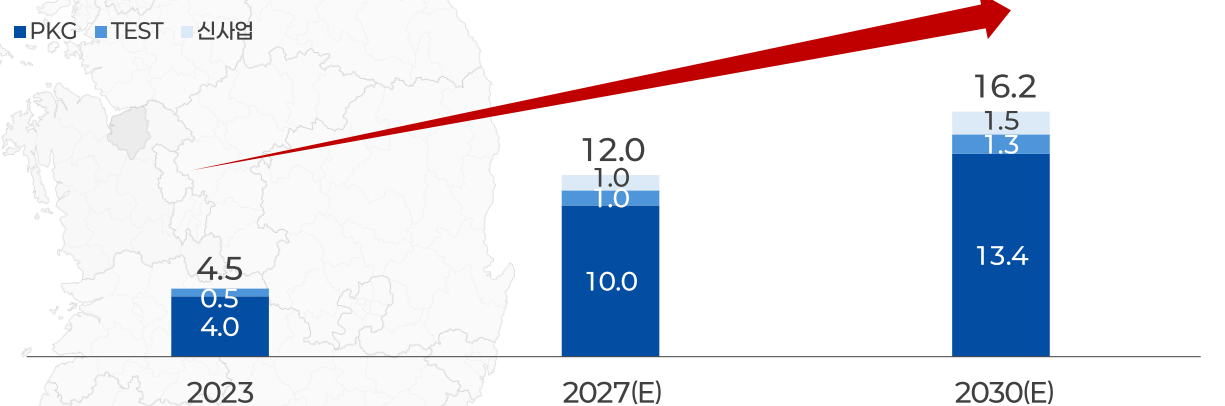
패키징 역량 개발 필수

출처: PRISMARK 24.3Q 보고서 기준

Global OSAT 역량강화



하나미크론(아산) 매출 목표



주: PKG 매출은 상품 매출 포함

02. 하나마이크론 (2) 베트남

SK하이닉스 및 신규 고객사 물량 확대 → 2030년 매출액 12억 달러 달성 목표

글로벌 OSAT SCM 변동

미·중 갈등 심화 → 인도, 미국 주변국, 아세안으로
글로벌 SCM 변동 예상

미·중 갈등

글로벌 반도체 SCM 변동 전망



베트남 반도체 OSAT 수요 확대 기대

HM Vina(박장)

SK하이닉스 동반성장



HM Vietnam(박닌)

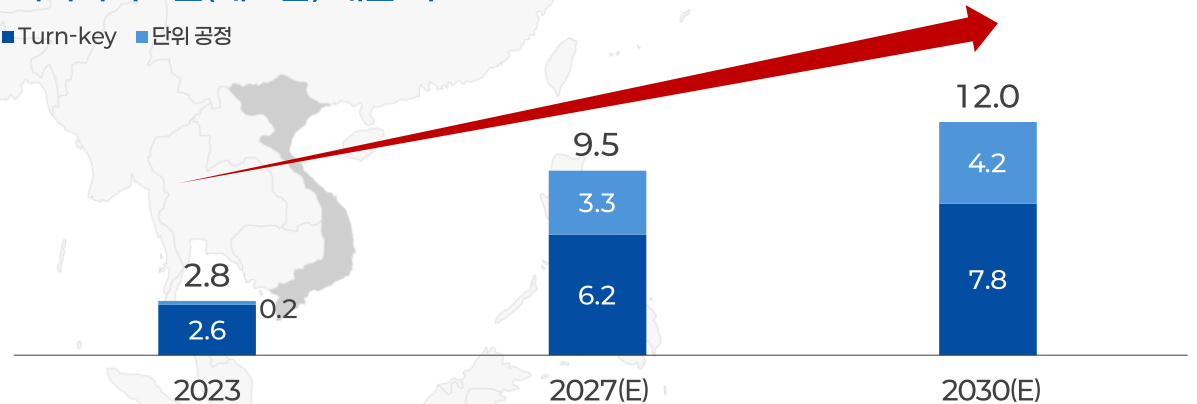
글로벌 고객사 매출 확보



하나마이크론(베트남) 매출 목표

■ Turn-key ■ 단위 공정

단위: 억달러



03. 브라질 법인

브랜드 사업 : 우호적 시장환경 + 제품 포트폴리오 확대 → 2030년 매출액 5억 달러 달성

브라질 시장 현황

글로벌 지정학적 Risk 및 미국 Reshoring에 따른 수혜국으로 부각
IT기기 제조사 브라질 내 증산 계획 중

반도체 산업 성장을 위한 정부 지원 확대
(PADIS프로그램 → 프로그램 연장 및 혜택 범위 확대)

전공정

후공정

기존 내수向 자국 제품에 세제혜택 제공

+

수출向 제품에 세제혜택 추가 ('25년 시행)

HT/HE 우호적 시장 환경 지속

제품 포트폴리오 강화

서버 디램, cSSD 등 제품 다변화



타깃 시장 확대

브라질 외 글로벌 시장 매출 확보



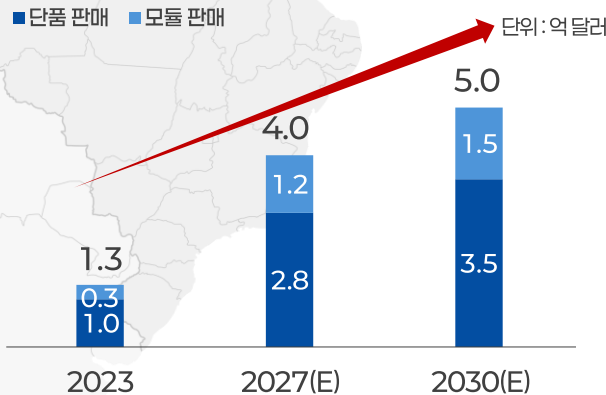
브라질



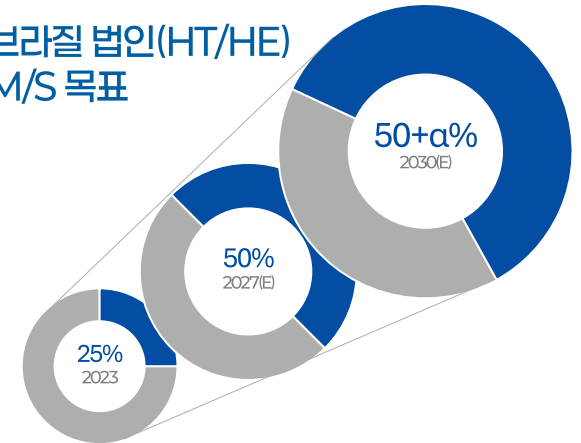
글로벌 메모리 시장



브라질 법인(HT/HE) 매출 목표




브라질 법인(HT/HE) M/S 목표




04. 하나머티리얼즈

본업 경쟁력 강화 및 미래 신규 사업 육성

선제적 CAPA 확보



반도체 Up-cycle
선제적 대비



글로벌 고객사
수주 물량 대응

Si/SiC 사업 One-Stop 생산능력 보유




고객사 맞춤형
주문 생산 대응




소재/가공 내재화 →
품질 레퍼런스 확보

제품 포트폴리오 다변화



Dielectric etch
(유전체 식각)
주로 사용

+



Conductor etch
(전도체 식각)
Si와 병행 사용


+

SiC 신규 매출
증대

+

Si-SiC 하이브리드
제품 개발

미래 신규 사업 육성



신소재 / 신제품
개발

기존 소재(Si, SiC)기술
신사업확대 &
배터리 소재



APPENDIX

1. 주요 일정
2. 인적분할 전/후 재무구조
3. 주주가치 제고 정책

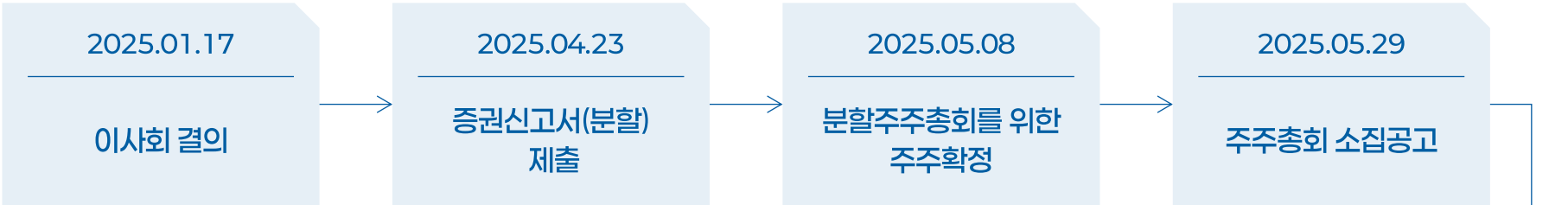


INNOVATIVE
SEMICONDUCTOR
SOLUTION PROVIDER

01. 주요 일정

'25년 1월 이사회 결의 후 6월 주주총회를 거쳐 8월 변경상장 및 재상장 예정

인적분할 예상 일정



2025.06.27~2025.08.05 매매거래정지기간



주: 상기 분할 일정은 예상 일정으로 관계기관과의 협의 및 기타 사정에 의하여 변경될 수 있음

02. 인적분할 전/후 재무구조

분할 전/후 재무상대표 (백만 원)

구분	분할 전	분할 후	
		분할존속회사	분할신설회사
유동자산	327,100	47,677	279,423
비유동자산	738,688	210,564	530,401
자산총계	1,065,788	258,241	809,824
유동부채	403,636	109,921	293,715
비유동부채	250,662	14,475	238,464
부채총계	654,298	124,396	532,179
자본금	32,872	10,692	22,180
기타불입자본	337,443	91,664	250,310
기타자본구성요소	10,877	1,191	5,155
이익잉여금(결손금)	30,298	30,298	-
자본총계	411,490	133,845	277,645

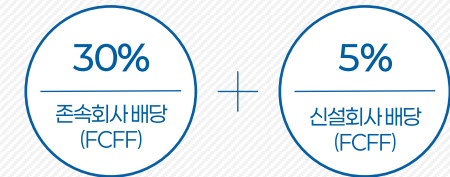
03. 주주가치 제고 정책

지주사 체제 개편 이후 주주가치 제고를 위한 중장기 전략 구축

01 주주환원정책 확대



- 중간/분기배당 확대 검토
- 주주환원 배당정책 공개 및 이행
 - 배당가능이익 범위 내 *잉여현금흐름 (FCFF, 별도 기준)의 30%(존속회사), 5%(신설회사) 이상 배당 지급 목표



02 경영 투명성 강화



- 신설회사(사업)의 사외이사를 2인으로 강화
- 의사결정 신속성 및 분야별 전문성 강화 (사외후보추천위원회, ESG위원회 운영)
- 특수관계인의 이사회 참여를 통한 책임경영 강화

03 주주 소통창구 운영 확대



- 이사회 및 주주총회 운영에 대한 정보공개 강화 (공시 및 홈페이지)
- NDR개최 & 홈페이지 내 IR 상담 창구 게시

04 내부통제 강화



- 내부통제 관련 규정 개정
- 내부 감사기능 강화 및 준법통제 준수현황 (사업보고서 공시)

*잉여현금흐름(FCFF) = EBIT * (1-법인세율) + 감가상각비 - CAPEX - 지분투자 - 순순전자본의 변동 - 자사주매입 - 배당금